

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



(10) Numéro de publication internationale
WO 2022/167634 A1

(43) Date de la publication internationale
11 août 2022 (11.08.2022)

WIPO | PCT

(51) Classification internationale des brevets :
G06K 19/077 (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2022/052825

(22) Date de dépôt international :
07 février 2022 (07.02.2022)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
FR2101198 08 février 2021 (08.02.2021) FR

(71) Déposant : LINXENS HOLDING [FR/FR] ; 37 rue des
Closeaux, 78200 MANTES-LA-JOLIE (FR).

(72) Inventeurs : GLARIS, Patrice ; c/o Linxens France, 37 rue
des Closeaux, 78200 MANTES-LA-JOLIE (FR). YEAP,
Yean-Wei ; c/o Linxens Singapore Pte. Ltd, 22 Changi
north way, Singapore 498810 (SG). THIENARD, Olivier

; c/o Linxens France, 37 rue des Closeaux, 78200 MAN-
TES-LA-JOLIE (FR). MOUSQUE, Valérie ; c/o Linxens
France, 37 rue des Closeaux, 78200 MANTES-LA-JOLIE
(FR).

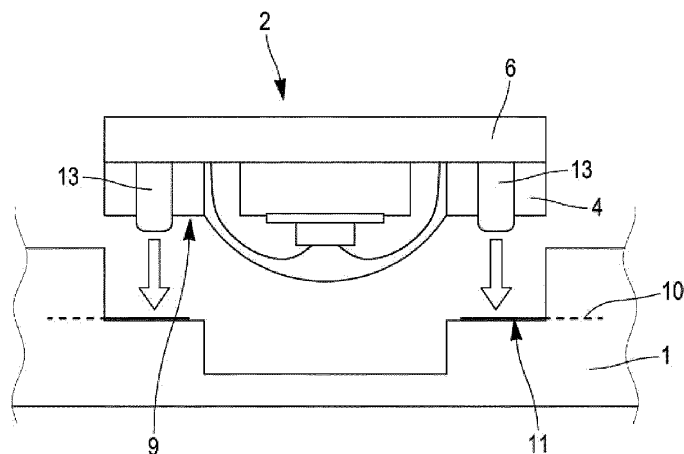
(74) Mandataire : INNOV-GROUP ; 310 avenue Berthelot,
69372 LYON Cedex 08 (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO,
AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA,
CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ,
EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR,
HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP,
KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING CHIP CARD MODULES AND BAND OF FLEXIBLE MATERIAL SUPPORTING SUCH MODULES

(54) Titre : PROCÉDÉ DE FABRICATION DE MODULES DE CARTE À PUCE ET BANDE DE MATERIAU FLEXIBLE SUPPORTANT DE TELS MODULES

[Fig. 5]



(57) Abstract: Method for manufacturing a module (2) for a chip card (1), wherein a polymer material (13) comprising conductive particles is deposited in two connection wells (12) or on two conductive tracks which are formed from a conductive sheet arranged at the rear face of the module (2). After being deposited, this polymer material (13) forms, at the rear face, an excess thickness which comes, during the insertion of the module (2), into contact with the ends of an antenna (10). Between the manufacture of the modules (2) and their insertion, the modules are arranged on a band which can be rolled up for storage.

(57) Abrégé : Procédé de fabrication d'un module (2) de carte à puce (1) dans lequel un matériau polymère (13) comprenant des particules conductrices est déposé dans deux puits de connexion (12) ou sur deux plages conductrices formées dans un feuillet conducteur disposé en face arrière du module (2). Ce matériau polymère (13) forme après dépôt une surépaisseur en face arrière qui vient, lors de l'encartage du module (2), au contact des extrémités d'une antenne (10). Entre la fabrication des modules (2) et leur encartage, les modules sont disposés sur une bande qui peut être enroulée sur elle-même en vue de son stockage.

[Suite sur la page suivante]

WO 2022/167634 A1

(84) **États désignés** (*sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible*) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

- avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))
- en noir et blanc ; la demande internationale telle que déposée était en couleur ou en échelle de gris et est disponible sur PATENTSCOPE pour téléchargement.